## **CONTROL DEVICE**

Publication number: JP10308335 Publication date: 1998-11-17

Publication date Inventor:

ASANO KAZUMASA

Applicant:

TOKYO ELECTRON LTD

Classification:

- international:

H01L21/677; G05B19/418; H01L21/02; H01L21/67;

G05B19/418; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/02;

H01L21/68

- European:

G05B19/418

Application number: JP19970115942 19970506 Priority number(s): JP19970115942 19970506 Also published as:

EP0877308 (A2)

US6258169 (B1)

US2001001386 (A1)

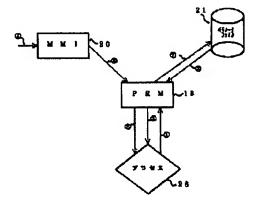
EP0877308 (A3) CN1199192 (A)

more >>

Report a data error here

## Abstract of JP10308335

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a control device which changes a process without stopping the process. SOLUTION: When a process 26 of one process chamber is operated, first, a parameter corresponding to the process from a PRM(parameter management part) 18 is required. The PRM 18 reads out the corresponding parameter from a parameter file 21, and transmits the parameter to the process 26. To stop the process 26, a stop instruction for the process 26 is inputted, then the instruction is inputted to the PRM 18 through an MMI(manmachine interface part). The PRM 18 rewrites an appropriate parameter in the parameter file 21, and further transmits the appropriate parameter to the process 26.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平10-308335

(43)公開日 平成10年(1998)11月17日

(51) Int.Cl.	識別記号	F I		
H 0 1 L 21/02		H01L 21/02	Z	
21/68		21/68	Α	

## 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 8 頁)

	· ·		
(21)出願番号	<b>特願平9-115942</b>	(71)出願人	000219967 東京エレクトロン株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)5月6日		東京都港区赤坂5丁目3番6号
		(72)発明者	浅野 一征 東京都府中市住吉町2-30-7 東京エレ
			クトロン株式会社内
		(74)代理人	弁理士 須山 佐一

## (54) 【発明の名称】 制御装置

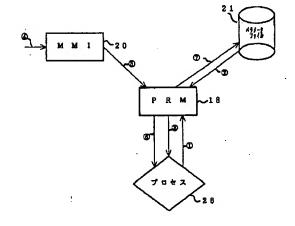
### (57)【要約】

する(図70)。

【課題】 プロセスを停止することなくプロセスの変更を行うことができる制御装置を提供すること。 【解決手段】 1つのプロセスチャンパのプロセス26

が動作をする際には、まずPRM18に対して当該プロセスに対応するパラメータを要求する(図7①)。PR

M18は、パラメータファイル21より対応するパラメータを読み出し(図7②)、そのパラメータをプロセス26に送信する(図7③)。プロセス26を停止する際には、プロセス26の停止命令を入力すると(図7④)、その命令はMMI20を介してPRM18に入力される(図7⑤)。PRM18は、パラメータファイル21内の該当するパラメータを書き替える(図7⑥)と共に、プロセス26に対して該当するパラメータを送信



[0005]

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 パラメータに応じて動作するプロセス

1

前記プロセスに対する前記パラメータを格納する格納手 段と、

前記プロセスに対する前記パラメータを設定する設定手 段と、

前記プロセスからの要求に応じて対応する前記格納バラ メータを返信し、前記設定手段によりパラメータが設定 されたとき当該設定されたパラメータを前記プロセスに 10 対して送信すると共に前記格納手段に格納されたパラメ ータを当該設定されたパラメータに書き替える管理手段 とを具備することを特徴とする制御装置。

【請求項2】 パラメータに応じて動作する複数のプロ セスと、

前記各プロセスに対する個別的な前記パラメータを格納 する第1の格納手段と、

前記各プロセスに対する共通の前記パラメータを共通化 して格納する第2の格納手段と、

前記プロセスに対する前記パラメータを設定する設定手 20 段と、

前記プロセスからの要求に応じて対応する前記いずれか の格納手段に格納されたパラメータを返信し、前記設定 手段によりパラメータが設定されたとき当該設定された パラメータを前記プロセスに対して送信すると共に前記 いずれかの格納手段に格納されたパラメータを当該設定 されたパラメータに書き替える管理手段とを具備すると とを特徴とする制御装置。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばクラスタツ ール装置等の半導体製造装置のプロセス制御に使われる 制御装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】一般に、半導体ウエハに対して各種の処 理、例えば成膜処理やエッチング処理、熱酸化処理等を 行うプロセスチャンバの前段側には、多数枚、例えば2 5枚のウェハを一度に収容できるカセットを収容するカ セットチャンバが設けられており、このカセットチャン バとプロセスチャンバとの間を搬送チャンバを介してウ 40 エハの受け渡しを行うようになっている。

【0003】通常、1つの搬送チャンパに対して複数、 例えば3個のプロセスチャンパを接続し、適宜搬送チャ ンバを介してカセットチャンバとこれら複数のプロセス チャンパとの間でウエハを受け渡し、各種の処理が行わ れるようになっている。

【0004】ところで、例えば上述したプロセスチャン バの交換や反応生成物の堆積によるチャンバの洗浄を行 う場合に一旦とれらの運転を停止して保守や清掃等を行 バのうち1個のプロセスチャンバについてのみそのよう な必要性が生じたならば、そのような必要性のあるプロ セスチャンバについてのみ運転を停止して保守や清掃等 を行い、他の2個のプロセスチャンバについては継続し て運転することが生産効率の点で好ましい。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、通常、

上述したプロセスチャンバ、搬送チャンバ及びカセット チャンバの動作制御は相互に密接に関連するプロセス制 御によって行われているため、上述したように特定の1 個のプロセスチャンバについてのみ運転を停止するよう に制御を切替えることは極めて困難である。例えば、特 定の1個のプロセスチャンバについてのみ運転を停止す る場合には、そのプロセスチャンバに対するプログラム を変更するだけではなく、例えば3個のプロセスチャン バ全体を包括的に制御するプログラム、更にはカセット チャンバや搬送チャンバのプログラム等も変更する必要 がある。

【0006】本発明は、かかる課題を解決するためにな されたもので、プロセスを停止することなくプロセスの 変更を行うことができる制御装置を提供することを目的 とする。

【0007】本発明の目的は、プロセスの変更を簡単に 行うことができる制御装置を提供することでもある。

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた め、請求項1記載の本発明の制御装置は、パラメータに 応じて動作するプロセスと、前記プロセスに対する前記 パラメータを格納する格納手段と、前記プロセスに対す 30 る前記パラメータを設定する設定手段と、前記プロセス からの要求に応じて対応する前記格納パラメータを返信 し、前記設定手段によりバラメータが設定されたとき当 該設定されたパラメータを前記プロセスに対して送信す ると共に前記格納手段に格納されたパラメータを当該設 定されたパラメータに書き替える管理手段とを具備す る。

【0009】請求項1記載の本発明の制御装置では、プ・ ロセスに対するパラメータを格納しておき、プロセスか らの要求に応じて対応する格納バラメータを返信するよ うに構成し、またプロセスを変更するときには変更後の パラメータを設定すれば、設定されたパラメータをプロ セスに対して送信すると共に格納されたパラメータを当 該設定されたパラメータに書き替えるように構成してい るので、プロセスを停止することなくプロセスの変更を 行うことができる。

【0010】請求項2記載の本発明の制御装置は、パラ メータに応じて動作する複数のプロセスと、前記各プロ セスに対する個別的な前記パラメータを格納する第1の 格納手段と、前記各プロセスに対する共通の前記パラメ う必要がある。その場合、例えば3個のプロセスチャン 50 ータを共通化して格納する第2の格納手段と、前記プロ

セスに対する前記パラメータを設定する設定手段と、前 記プロセスからの要求に応じて対応する前記いずれかの 格納手段に格納されたパラメータを返信し、前記設定手 段によりバラメータが設定されたとき当該設定されたバ ラメータを前記プロセスに対して送信すると共に前記い ずれかの格納手段に格納されたバラメータを当該設定さ れたパラメータに書き替える管理手段とを具備する。

【0011】請求項2記載の本発明の制御装置では、各 プロセスに対する共通のパラメータを共通化して格納す 要となり、またメモリの使用量を少なくできる。・

#### [0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施する場合の形 態について図面に基づいて説明する。

【0013】図1は本発明の一実施形態に係る半導体ウ エハ製造装置の構成を示す平面図である。

【0014】との半導体ウエハ製造装置は、半導体ウエ ハに対して各種の処理例えば成膜処理やエッチング処理 や熱酸化処理等を行う複数例えば3つのプロセスチャン できるカセットC1、C2を収容するカセットチャンバ 4、5と、プロセスチャンバ1、2、3とカセットチャ ンバ4, 5との間でウエハWの受け渡しを行う搬送チャ ンバ6とを備えて構成される。各チャンバ間はゲートバ ルブGを介して開閉自在に連結されている。搬送チャン バ6内には、屈伸動作及び回転動作が可能な例えば多関 節式の搬送アーム7が設けられており、この搬送アーム 7によりチャンバ間でのウエハWの搬送が行われる。カ セットC1、C2はカセットチャンバ4,5内に取り込 まれる際に90度反転されると共にそのカセットC1、C 30 れる。 2のウエハ挿脱口が搬送チャンバ6内の中心を向くよう に回転され、以て搬送アーム7によるウエハ♥の出し入 れが可能な姿勢に設置される。

【0015】図2はこのような半導体ウエハ製造装置を 制御する制御装置の構成を示す図である。

【0016】マシンコントローラ (MC) 11~16 は、各プロセスチャンパ1, 2, 3、カセットチャンパ 4、5、及び搬送チャンバ6を個別に制御する。これら マシンコントローラ11~16は、その上位制御手段で あるメインコントローラ (EC) 17により統括的に制 40 御される。メインコントローラ(EC)17は、管理手 段としてのパラメータ管理部 (PRM) 18、タッチバ ネルディスプレイ19との間のインタフェース手段(バ ラメータを設定する設定手段) としてのマンマシンイン タフェース部(MMI)20、及びパラメータを格納す る格納手段としてのパラメータファイル21を備える。 マシンコントローラ(MC)11~16及びメインコン トローラ(EC)17における各部は、パラメータに応 じて動作するプロセスである。

【0017】図3はこれらプロセスとバラメータ管理部 50

(PRM) 18とパラメータファイル21 に格納された 各パラメータとの関係を示した図である。

【0018】パラメータファイル21には、ローカルパ ラメータファイル22、グローバルパラメータファイル 23、エディットパラメータファイル24及びパラメー タコントロールファイル25が格納されている。これら 各ファイルは、ソースパラメータファイルとこれらのパ ラメータをコンパイルした例えばテキスト形式のパラメ ータファイルの両方を有する。このようにソースパラメ るようにしたので、関連するパラメータの書き替えは不 10 ータファイルについてテキスト形式のパラメータファイ ルを持たせることで編集の容易化を図っている。 各口 ーカルパラメータファイル22には、各プロセス26に 対応した個々的なパラメータが格納される。ローカルパ ラメータファイル22に格納されたパラメータは、各プ ロセス26の要求に応じてパラメータ管理部(PRM) 18を介して各プロセス26にマップされる。

【0019】グローバルパラメータファイル23には、 プロセス間で共通のパラメータが格納される。グローバ ルパラメータファイル23に格納されたパラメータは、 バ1, 2, 3と、多数枚例えば25枚のウエハWを収納 20 パラメータ管理部 (PRM) 18を介してグローバルメ モリエリア27にマップされる。グローバルメモリエリ ア27にマップされたパラメータは、パラメータ管理部 (PRM) 18やプロセス26により読み書きされる。 【0020】エディットパラメータファイル24には、 これらのパラメータうち編集可能なパラメータが格納さ れる。エディットパラメータファイル24を参照すると とで、パラメータが編集可能かどうかが判断できる。 【0021】パラメータコントロールファイル25に は、これらパラメータの場所を示すパラメータが格納さ

> 【0022】図4はローカルパラメータファイル22の 一例を示す図であり、ことではプロセスチャンバ全体に 対するファイルを示している。

> 【0023】このファイルにおいて第1行の左側より順 に、「u」はコマンド、「1」は行番号、「0」はプロ セスチャンバの台数の最小値、「3」はプロセスチャン バの台数の最大値、「3」はプロセスチャンバの台数の デフォルト値、「3」はプロセスチャンバの台数の現在 値をそれぞれ示している。

【0024】図5はローカルパラメータファイル22の 他の例を示す図であり、ことでは1つのプロセスチャン バに対するファイルを示している。

【0025】このファイルにおいて第1行の左側より順 に、「u」はコマンド、「1」は行番号、「0」はプロ セスチャンバ停止の値(最小値)、「1」はプロセスチ ャンバ動作の値(最大値)、「1」はプロセスチャンバ の停止・動作のデフォルト値(ここでは動作)、「1」 はプロセスチャンバの停止・動作の現在値(ここでは動 作)をそれぞれ示している。

【0026】図6(a)はパラメータ管理部(PRM)

18を介して各パラメータファイルから各プロセス26 等に送信されるデータの形式を示す図であり、データ 型、現在値、最大値、最小値の順番でデータが送信され る。図6(b)に図5のファイルの送信データの一例を 示す。

【0027】図7は1つのプロセスチャンバが動作・停 止する際の制御装置内の処理の流れを示す図である。

【0028】1つのプロセスチャンバのプロセス26が 動作をする際には、まずパラメータ管理部(PRM)1 る(図70)。 これに対して、パラメータ管理部 (PR M) 18は、パラメータファイル21より対応するパラ メータを読み出し(図7②)、そのパラメータをプロセ ス26に送信する(図73)。これにより、プロセス2 6の動作が実行される。

【0029】一方、このようなプロセス26を停止する 際には、まずユーザがタッチパネルディスプレイ19を 介してプロセス26の停止命令を入力すると(図7 ④)、その命令はマンマシンインタフェース部 (MM) 力される(図75)。これに対して、パラメータ管理部 (PRM) 18は、パラメータファイル21内の該当す るパラメータを書き替える(図76)と共に、プロセス 26に対して該当するパラメータを送信する(図7

【0030】図8は1つのプロセスチャンバのプロセス 26を停止した場合に対応するパラメータを書き替える 様子を示した図であり、同図(a)は動作中のファイル を示し、同図(b)は停止中のファイルを示す。これら の図に示すように、動作中は当該行右欄の現在値が 「1」となっているが、停止すると現在値が「0」に書 き替えられる。

【0031】ところで、このように1つのプロセスチャ ンバを停止すると、図4に示したプロセスチャンバ全体 に対するファイルや搬送チャンバに対するファイル等も 書き替える必要がある。

【0032】図9にプロセスチャンバ全体に対するパラ メータを書き替える様子を示す。同図(a)は3つのプ ロセスチャンバが動作中のファイルを示し、同図(b) は1つのプロセスチャンバが停止となり2つのプロセス 40 チャンバが動作中のファイルを示す。これらの図に示す ように、3つのプロセスチャンパが動作中の場合は当該 行右欄の現在値が「3」となっているが、1つのプロセ スチャンバが停止すると現在値が「2」に書き替えられ る。なお、搬送チャンバ等についても同様に書き替えら れる。

【0033】 このように1つのファイルのパラメータを 書き替えたときに関連するパラメータを書き替える手段 としては、例えば予め関連するパラメータを集めたファ イルを持たせ、パラメータの書き替えがあったときには 50 とを具備するので、プロセスを停止することなくプロセ

このファイルに基づき関連するパラメータを書き替える ようにすればよい。また、パラメータを各プロセスが共 通の値として使用できるような場合にはグローバルパラ メータファイル23に登録すれば、このような関連する バラメータの書き替えは不要となり、またメモリの使用 **量を少なくできる。** 

【0034】本実施形態に係るシステムでは、例えば1 つのプロセスチャンバを停止する際に他のプロセスを停 止する必要がなくなる。別言すると、他のプロセスを動 8に対して当該プロセスに対応するバラメータを要求す 10 作させながら1つのプロセスを停止することができる。 との結果、例えば3つのプロセスチャンバ1, 2, 3に メンテナンスが必要な場合には、第2及び第3のプロセ スチャンバ2、3の動作を継続しながら、第1のプロセ スチャンバ1のみを停止してメンテナンスを行い、次に 第1及び第3のプロセスチャンバ1、3の動作を継続し ながら、第2のプロセスチャンバ2のみを停止してメン テナンスを行い、次に第1及び第2のプロセスチャンバ 1.2の動作を継続しながら、第3のプロセスチャンバ 3のみを停止してメンテナンスを行うことで、システム 1)20を介してパラメータ管理部(PRM)18に入 20 全体を停止することなくシステム全体のメンテナンスを 行うことができる。

> 【0035】なお、本発明は、上述した実施の形態に限 定されず、その技術思想の範囲内で様々な変形が可能で ある。

【0036】例えば、上述した実施形態では、プロセス チャンバに関連するバラメータを変更する例について説 明したが、他のプロセスのパラメータを変更することも もちろん可能である。例えば、マンマシンインタフェー ス部(MMI)20におけるパラメータ、例えば言語の 30 パラメータ等についても変更が可能である。マンマシン インタフェース部 (MMI) 20 における言語のパラメ ータを変更した場合の画面例を図10及び図11に示 す。図10に示す「言語」の「現在値」を「英語」に変 更すると、対応するパラメータファイルにおけるパラメ・ ータが書き替えられ、図11に示すように画面表示が英 語になる。

【0037】また、本発明に係る制御装置は、クリーン トラックやLCD製造装置等の他の半導体製造装置にも 適用することができる。

[0038]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、 パラメータに応じて動作するプロセスと、前記プロセス に対する前記パラメータを格納する格納手段と、前記ブ ロセスに対する前記パラメータを設定する設定手段と、 前記プロセスからの要求に応じて対応する前記格納バラ メータを返信し、前記設定手段によりパラメータが設定 されたとき当該設定されたパラメータを前記プロセスに 対して送信すると共に前記格納手段に格納されたパラメ ータを当該設定されたパラメータに書き替える管理手段 スの変更を行うことができる。

【0039】また、本発明では、パラメータに応じて動作する複数のプロセスと、前記各プロセスに対する個別的な前記パラメータを格納する第1の格納手段と、前記各プロセスに対する前記各プロセスに対する共通の前記パラメータを共通化して格納する第2の格納手段と、前記プロセスに対する前記パラメータを設定する設定手段と、前記プロセスからの要求に応じて対応する前記いずれかの格納手段に格納されたパラメータを返信し、前記設定手段によりパラメータが設定されたとき当該設定されたパラメータを前記プロセスに対して送信すると共に前記いずれかの格納手段に格納されたパラメータを当該設定されたパラメータに書き替える管理手段とを具備するので、関連するパラメータの書き替えは不要となり、またメモリの使用量を少なくできる。

#### 【図面の簡単な説明】

[図1] 本発明の実施形態が採用された半導体ウエハ製造装置の全体構成の平面図である。

【図2】図1に示した半導体ウェハ製造装置を制御する 制御装置の構成を示す図である。

【図3】図2に示したプロセスとパラメータ管理部とパラメータファイルに格納された各パラメータとの関係を示した図である。

【図4】図2に示したローカルバラメータファイル(プロセスチャンバ全体)の一例を示す図である。

【図5】図2に示したローカルパラメータファイル(1つのプロセスチャンバ)の一例を示す図である。

【図6】本発明の実施形態において送信されるデータの 形式を示す図である。 \*【図7】本発明の実施形態において1つのプロセスチャンパが動作・停止する際の制御装置内の処理の流れを示す図である。

【図8】本発明の実施形態において1つのプロセスチャンパのプロセスを停止した場合に対応するパラメータを 書き替える様子を示した図である。

【図9】本発明の実施形態においてプロセスチャンバ全体に対するパラメータを書き替える様子を示した図である

) 【図10】本発明の実施形態における画面の一例を示す 図である。

【図11】本発明の実施形態における画面の一例を示す 図である。

#### 【符号の説明】

1~3 プロセスチャンバ

4、5 カセットチャンパ

11~16 マシンコントローラ (MC)

17 メインコントローラ (EC)

18 パラメータ管理部(PRM)

20 19 タッチパネルディスプレイ

20 マンマシンインタフェース部 (MMI)

21 パラメータファイル

22 ローカルパラメータファイル

23 グローバルパラメータファイル

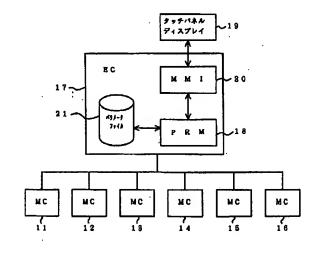
24 エディットパラメータファイル

25 パラメータコントロールファイル

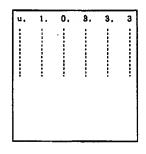
26 プロセス

27 グローバルメモリエリア

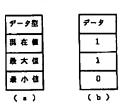
【図2】

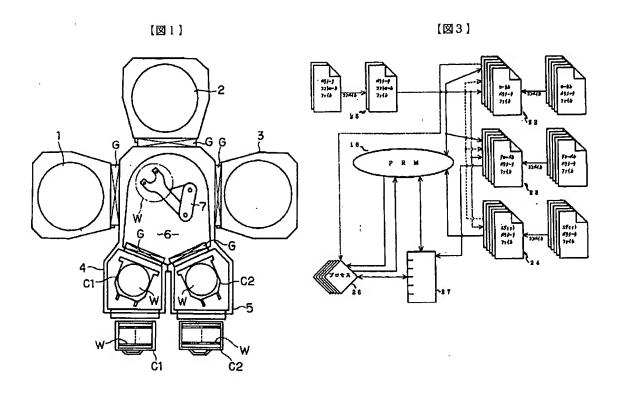


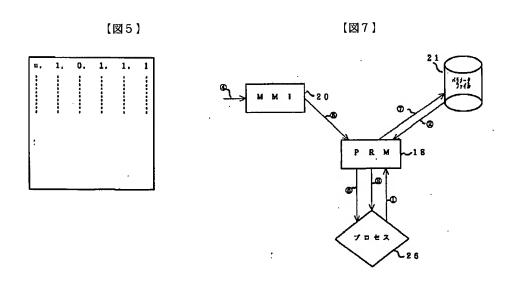
【図4】

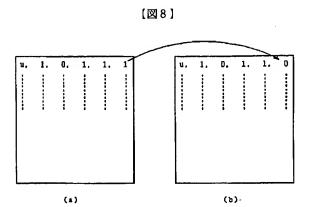


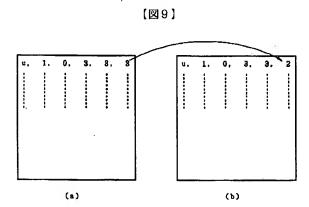
【図6】











【図10】

共通パラメータ編集			スフ グ	ーリン	ログラメ -タ	画面選択		
設定項目		現在位		再起動時の散定				
12		×	漏	英語		<b>A</b>		
WARM/COLD		α	LD	COLD		_		
使用可能オペレータレベル		サービスエンジニア		サービスエンジニア				
起動時のオペレータレベル		オペレータ		オペレータ				
オペレータ名		TEST		TEST				
キーボードタイプ		106タイプ		106タイプ		•		
シャットダウンの輸館		避択可能		選択可能		-		
シャットダウンのタイムアウト		1089		1089		¥		
終了	中止	クリア						

【図11】

Common Parameter Edit		S	naciina l"	hannel arameter		Sel	ect een	
Setting Menu		Current- Value		Restart	Restart Setting			
Lenguage		English		English		<b>A</b>	]	
Warm/Cold		Cold		Cold				
Max (	Max Operation Type		Service	Operation	Service	Operation		
Initial	Initial Operation Type		Normal	Operation	Normal	Operation		
Operator Name		TEST		TEST				
Keyboard Type		Туре-106		Type-106		▼		
Shutdown Functions		Selec	t Enable	Select	Enable			
· Shutdown Timeout		10 Sec		10 Sec		▼	_	
Close	Cancel	Clear		T				